

北京赛微电子股份有限公司

关于控股子公司 MEMS 硅晶振通过验证并启动试产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，北京赛微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司赛莱克斯微系统科技（北京）有限公司（以下简称“赛莱克斯北京”）代工制造的某款 MEMS（Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，即微电子机械系统，简称为微机电系统）硅晶振通过了客户验证，赛莱克斯北京收到该客户发出的采购订单，启动首批 MEMS 硅晶振 8 英寸晶圆的小批量试生产。

MEMS 硅晶振以硅为原材料，通过采用 MEMS 工艺制造形成一个微机械振动结构，以产生稳定的振动频率，具有体积小、抗冲击、可编程、可批量生产等特点。晶振的应用领域十分广泛，包括可穿戴设备、家用电器、智能家居、手机电脑等消费领域，导航、基站、通讯、汽车等工业领域，以及原子钟、测量设备、遥测、遥感、遥控等科研领域。

近年来，赛莱克斯北京持续加大研发投入，自主积累基础工艺，积极探索各类 MEMS 器件的生产诀窍，努力为通信计算、生物医药、工业汽车、消费电子等各领域客户，尤其是中国本土客户提供优质的 MEMS 工艺开发及晶圆制造服务，积极推动公司在本土形成和提升自主可控的 MEMS 生产制造能力，加速国产替代进程。

根据产业发展规律及公司境内外产线的实际运营经验，不同类别 MEMS 芯片一般都需要经历从工艺开发到风险试产、规模量产的过程，所耗时间存在差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 8 月 1 日